

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ E05B 49/00	(11) 공개번호 특 1996-0011036	(43) 공개일자 1996년 04월 20일
(21) 출원번호 특 1995-0031148		
(22) 출원일자 1995년 09월 21일		
(30) 우선권주장 (71) 출원인	94-235494 1994년 09월 29일 일본(JP) 가부시기가이샤 알파 다카야마 기요히코	
(72) 발명자	일본국 가나가와켄 요코하마시 가나가와구 후꾸우라 1-6-8닛산 지도샤 가부시기가이샤 쓰지 요시후미 일본국 가나가와켄 요코하마시 가나가와구 다카라쵸 2반지 오자와 다쿠로 일본국 가나가와켄 요코하마시 이소고구 구리끼 2-5-14 비-203 와따누끼 요시오 일본국 가나가와켄 에비나시 스키꾸보 967-5 서대석	
(74) 대리인	서대석	

심사청구 : 없음

(54) 전자부품내장 키장치 및 그 제조방법

요약

공동내의 배치한 키프레이트를 성형틀에 의해 확실하게 유지하여 수지성형을 해서 전자부품내장 키장치를 제조한다. 본 발명에 의한 전자부품내장 키장치의 헤드(2)는 내측케이스부(6)와 내측케이스부(6)의 외측에 고착되는 외층피복부(8)와 내측케이스부(6)에 형성되고 또한 키프레이트(1)의 머리부(1a)로부터 키프레이트(1)의 잘라낸 부분(3a)쪽으로 키프레이트(1)와 거의 평행하게 배치되는 요입부(5)를 구비하고 있다. 요입부(5)내에는 홀더(7)에 의해 전자부품(4)이 유지되고 외층피복부(8)에 형성된 개구부(8a)의 외면에 내측케이스부(6)의 접촉부(6c)가 부분적으로 노출된, 전자부품내장 키장치의 제조시에 키프레이트(1)를 성형틀의 공동(23)내에 배치했을 때 내측케이스부(6)의 접촉부(6c)를 성형틀(22)에 접촉시켜서 키프레이트(1)를 공동(23)내에 고정시킨 후 공동(23)내에 용융수지를 공급하여 내측케이스부(6)의 외측에 외층피복부(8)를 형성한다.

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]
전자부품내장 키장치 및 그 제조방법
[도면의 간단한 설명]
제1도는 본 발명에 의한 전자부품내장 키장치의 실시예를 도시한 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

키코드를 부여하는 잘라낸 부분(3a)를 형성하는 블레이드부(3)를 구비한 키프레이트(1)와 키프레이트의 단부에 고정된 수지제의 헤드(2)를 가진 키장치에 있어서, 헤드(2)는 경질수지에 의해 형성됨과 동시에 키프레이트(1)의 머리부(1a)로부터 키프레이트(1)의 잘라낸 부분(3a)쪽으로 키프레이트(1)와 거의 평행한 요입부(5)를 가진 내측케이스부(6)와 내측케이스부의 외측에 고착되고 또한 연질수지에 의해 형성된 외층피복부(8)를 구비하고, 내측케이스부(6)의 요입부(5)내에 전자부품(4)이 배치되며, 외층피복부(8)에 형성된 개구부의 블레이드부(3)쪽의 내면에 내측케이스부(6)의 접촉부(6c)를 부분적으로 노출시킨 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 내측케이스부(6)의요입부(5)내에 거는 탄성손톱부(9)를 가진 홀더(7)에 의해 전자부품(4)을 유지하는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치.

청구항 3

제1항에 있어서, 내측케이스부(6)는 한 쌍의 케이스편(6a,6b)을 구비하며 한 쪽의 케이스편(6a)에는 단성손톱부(9)를 형성하고 다른 쪽의 케이스편(6b)에는 관통구멍을 형성하여 한 쪽 케이스편(6a)의 단성손톱부(9)를 다른 쪽 케이스 편(6a)의 관통구멍을 통해서 다른 쪽의 케이스편에 거는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치.

청구항 4

제1항에 있어서, 내측케이스부(6)의 접촉부(6c)를 외충피복구(8)와 거의 동일평면에서 노출시킨 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치.

청구항 5

키이크드를 부여하는 잘라낸부분(3a)을 형성하는 블레이드부(3)를 구비한 키이플레이트(1)와 키이플레이트의 단부에 고정된 수지재의 헤드(2)를 가진 키이장치에 있어서, 헤드(2)는 경질수지에 의해 형성됨과 동시에 키이플레이트(1)의 머리부(1a)로부터 키이플레이트(1)의 잘라낸 부분(3a)쪽으로 키이플레이트(1)와 거의평행한 요입부(5)를 가진 내측케이스부(6)와 태측케이스부의 외측에 고착되고 또한 연질수지에 의해 형성된 외충 피복구(8)를 구비하고, 내측케이스부(6)의 요입부(5)내에 로크장치의 안테나로부터의 신호에 의해 기동하는 전자부품(4)이 배치되며, 상기 키이플레이트(1)의 머리부에는 블레이드부(3)의 단부로부터 옆쪽으로 뻗어 블레이드부와 함께 전자부품(4)을 L자형으로 둘러싸는 차양부(1c)를 형성한 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치.

청구항 6

키이플레이트(1)의 머리부(1a)에 한 쌍의 케이스편(6a,6b)을 장착하여 내측케이스부(6)를 키이플레이트(1)의 머리부(1a)에 부착하는 공정과, 내측케이스부(6)를 부착한 키이플레이트(1)를 성형틀(22)의 공동(23)내에 배치하고 또한 내측케이스부(6)의 접촉부(6c)를 성형틀(22)에 접촉시켜서 키이플레이트(1)를 공동내에 고정함과 동시에 슬라이드(26)을 내측케이스부(6)의 요입부(5)내에 삽입하는 공정과, 공동(23)내에 용융수지를 공급하여 내측케이스(6)부의 외측에 외충피복부(8)를 형성하는 공정과, 슬라이드(26)을 내측케이스부(6)의 요입부(5)로부터 제거함과 동시에 키이플레이트(1)를 성형틀(22)로부터 꺼내는 공정과, 내측케이스부(6)의요입부(5)내에 전자부품(4)을 삽입하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

청구항 7

제6항에 있어서, 키이플레이트(1)의 블레이드부(3)를 포스트(20)의 반이구멍(21)에 정착한 후 포스트(20)를 성형틀(22)에 인접하게 배치하여 키이플레이트(1)의 머리부(1a)를 성형틀(22)의 공동(23)내에 배치하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

청구항 8

제6항에 있어서, 키이플레이트(1)와 거의 수직으로 배열한 여러개의 접촉부(6c)의 사이에 외충피복구(8)를 형성하는 용융수지를 주입하는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

청구항 9

제6항에 있어서, 내측케이스부(6)를 키이플레이트(1)의 머리부(1a)에 부착했을때 한 쌍의 케이스편(6a,6b)에 의해 형성되는 단차부는 외충피복구(8)를 형성하는 용융수지를 주입하는 게이트로부터 어긋난 위치에서 공동(23)내에 비치되는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

청구항 10

제9항에 있어서, 단차부를형성하는 한 쌍의 케이스편(6a,6b)중, 게이크(27)에 가까운 한 쪽 케이스편(6a)을 두껍게 하고 게이트(27)로부터 먼 다른 쪽의 케이스편(6b)을 얇게 한것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

청구항 11

제6항에 있어서, 내측케이스부(6)의 한 쪽 케이스편(6a)에는 탄성손톱부(9)를 형성하고 다른 쪽의 케이스편(6b)에는 관통구멍을 형성하여 한 쪽 케이스편(6a)의 단성손톱부(9)를 다른 쪽 케이스편의 관통구멍을 통해 다른 쪽의 케이스편(6b)에 걸고 관통구멍에는 연질수지를 주입하는 것을 특징으로 하는 전자부품내장 키이장치의 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

